



中华人民共和国国家标准

GB/T 39842—2021

集成电路(IC)卡封装框架

Integrated circuit (IC) card packaging framework

2021-03-09 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本标准起草单位:山东新恒汇电子科技有限公司。

本标准主要起草人:朱林、邵汉文、王广南、陈铎。

集成电路(IC)卡封装框架

1 范围

本标准规定了集成电路(IC)卡封装框架(以下简称 IC 卡封装框架)的技术要求、检验方法、检验规则、包装、贮存和运输。

本标准适用于 IC 卡封装框架,包括接触式 IC 卡封装框架和非接触式 IC 卡封装框架。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾

GB/T 2423.50 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cy:恒定湿热 主要用于元件的加速试验

GB/T 2423.51—2020 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ke:流动混合气体腐蚀试验

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 13557 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法

GB/T 16545—2015 金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除

GB/T 16649.2 识别卡 带触点的集成电路卡 第 2 部分:触点的尺寸和位置

GB/T 16921—2005 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X 射线光谱法

GB/T 17554.1 识别卡 测试方法 第 1 部分:一般特性测试

GB/T 25933—2010 高纯金

GB/T 25934—2010(所有部分) 高纯金化学分析方法

GB/T 32642—2016 平板显示器基板玻璃表面粗糙度的测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

IC 卡封装框架 IC card packaging framework

由绝缘材料与带图形的导电材料叠压而成,是保护芯片的载体,也是芯片与外部设备进行信息交换的接口。

注:从数据传输方式上可分为单界面接触式 IC 卡封装框架、双界面接触式 IC 卡封装框架和非接触式 IC 卡封装框架。

3.2

单界面接触式 IC 卡封装框架 single side IC card packaging framework

只能以接触的方式,实现与外部设备信息交换的 IC 卡封装框架。